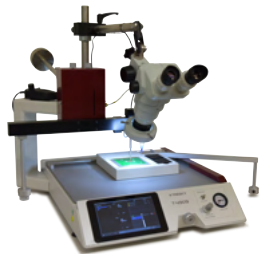


ÜBERSICHT 2024

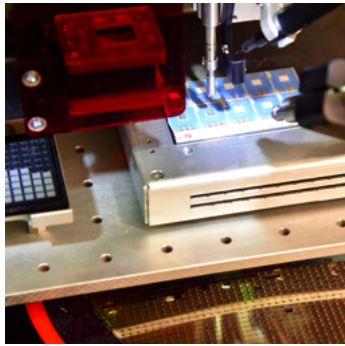
TRESKY Lösungen für die Mikroelektronik



von manuell
zu halbautomatisch

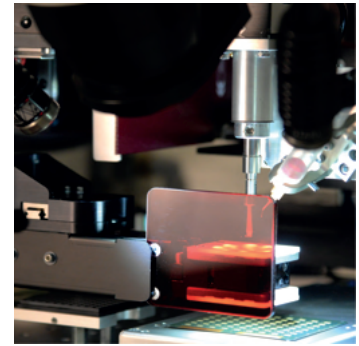


MIKROFERTIGUNG



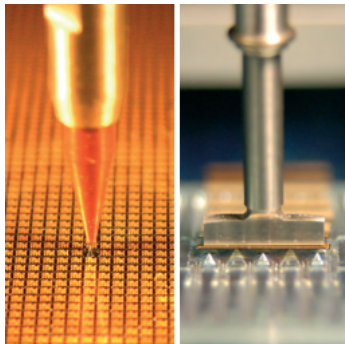
Die Bestückung

Sub-Mikron-Bonden
Vollständige Prozesskontrolle
Kontrolle der Bondkraft
True Vertical Technology™
Intuitiv und einfach in der Anwendung

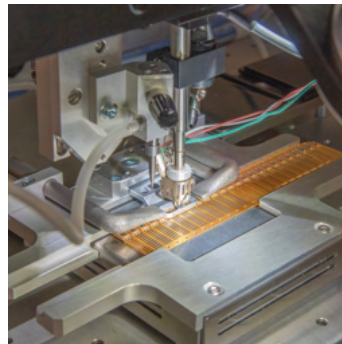


Flip-Chip & 3D Verpackung

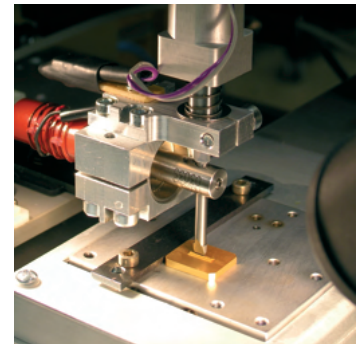
TRESKY ÜBERSICHT



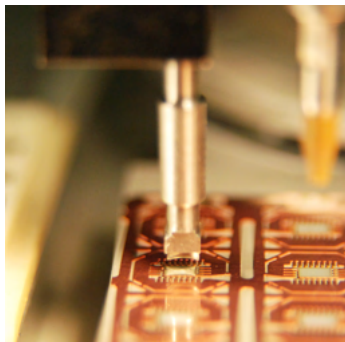
Die Sortierung



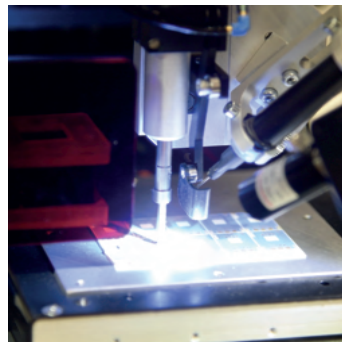
Eutektisches Kleben



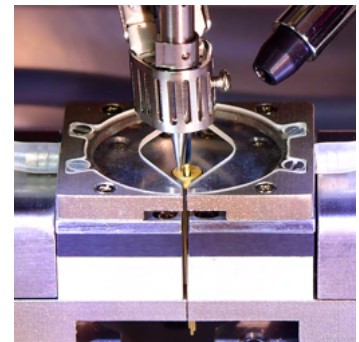
Ultraschall & Thermosonic



Dosieren & Stempeln



UV Härtung



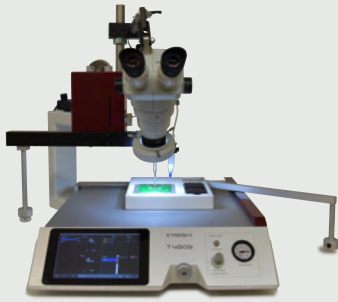
TO eutektisches Kleben



TRESKY

Dr. TRESKY AG
Schweiz
tresky@tresky.com
www.tresky.com

T-4909-AE



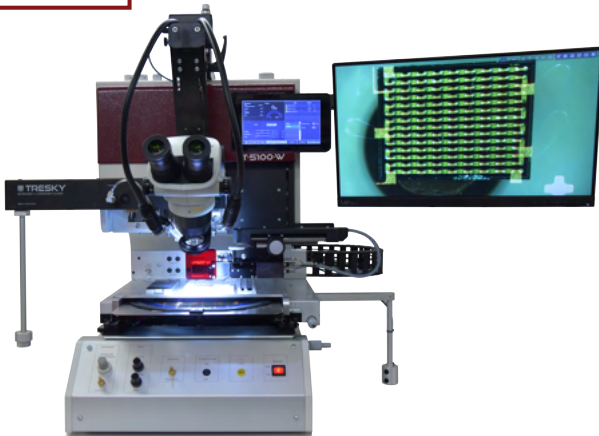
Kostengünstiges Die-Bonden-System

- Manuelle Z-Achse mit digitaler Anzeige der Bondkraft
- Integrierter Dispenser

Applikationen:

Flip-Chip Bonding, Eutektik, Die Bestückung, ...

T-5100 & T-5100-W



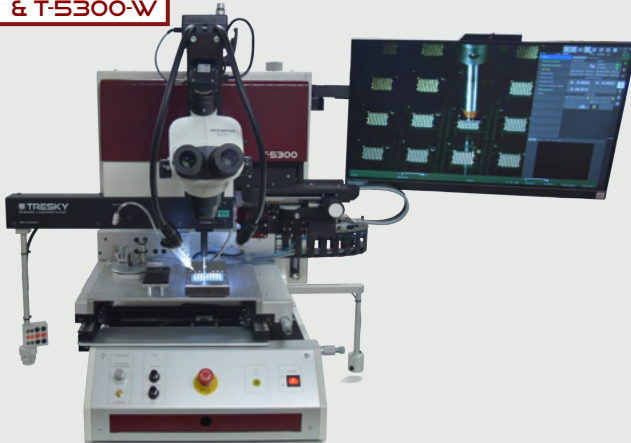
Präzises Multi-Anwendungssystem

- Manuelle Z-Achse mit digitaler Anzeige der Bondkraft
- Integrierter Dispenser
- Einfaches und sicheres Aufnehmen von Wafern auf dem T-5100-W

Applikationen:

Sub-Mikron-Bonden, Flip-Chip, Die Bestückung, Eutektik, Eutektisches TO Bonden, Thermosonic, ...

T-5300 & T-5300-W



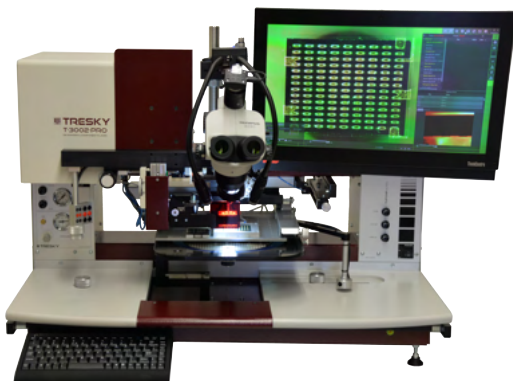
Präzises Multi-Anwendungssystem

- Motorisierte Z-Achse, aktive Kraftkontrolle
- PC-Steuerung für alle Bonding-, Temperatur- und Visionparameter
- Einfaches und sicheres Aufnehmen von Waffel/ Gel-Packs, ...
- Integrierter Dispenser
- Einfaches und sicheres Aufnehmen von Wafern auf dem T-5300-W

Applikationen:

Sub-Mikron Bonden, Flip-Chip, Pre-Sinter Bonding, Eutektische Die Bestückung, Eutektisches TO Bonden, Thermosonic & Thermokompression, Stapeln, Klebstoffe mit Bond-liniendicke, UV Härtung, ...

T-3000-PRO-HF & T-3002-PRO-HF



High Force Multi-Anwendungssystem

- Motorisierte Z-Achse, Kraftkontrolle (bis zu 500N)
- PC-Steuerung für alle Bonding-Parameter und Bildgebung
- Integrierter Dispenser
- Einfaches und sicheres Aufnehmen vom Wafer, auf dem T-3002-PRO-HF

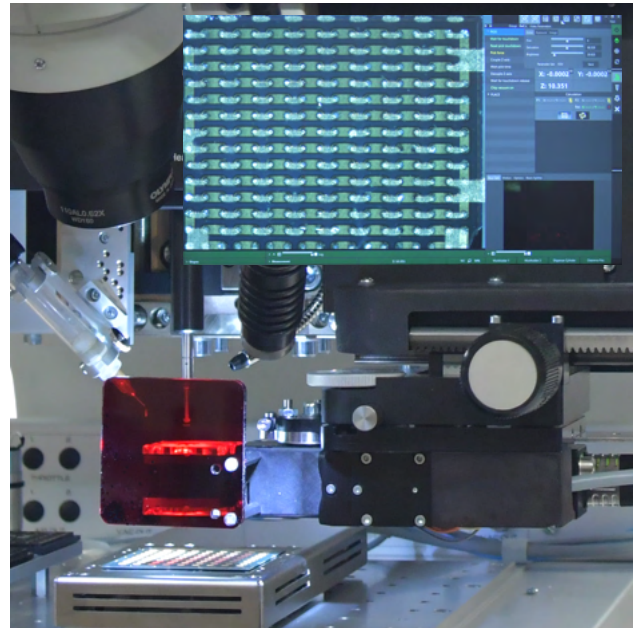
Applikationen:

Flip-Chip, Pre-Sinter Bonding, Eutektische Die Bestückung, Eutektisches TO Bonden, Thermosonic & Thermokompression, Stapeln, Klebstoffe mit Bond-liniendicke, UV Härtung, ...

FLIP-CHIP

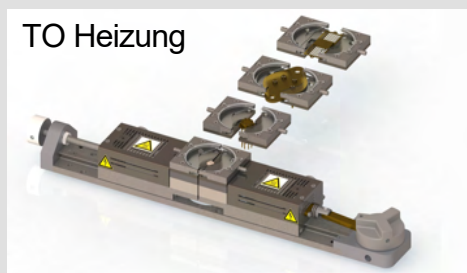
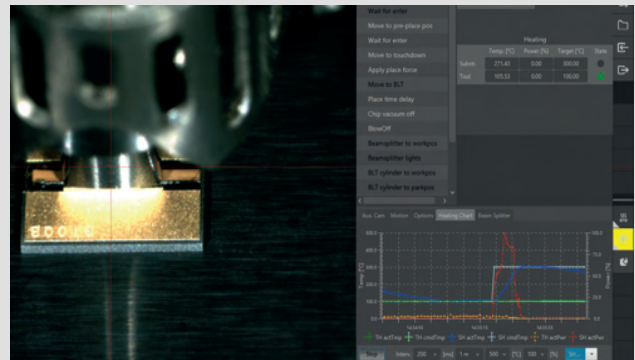
Hochauflösende Platzierungseinheit mit Beam-Splitter für ultrapräzise Mehrpunkt-Ausrichtung mit submikroner Auflösung. Zusätzliche Ausrichtungsfunktionen wie Kantenerkennung für die obere Chip-Ausrichtung.

- Hochpräziser Beam-Splitter mit 1x oder 2x hochauflösender Optik
- 400-facher digitaler Zoom Ultra-HD-Kamera
- Mehrpunkt-Ausrichtung (mit verschiedenen Reichweiten) für hohe Genauigkeit
- Optische Auflösung von 1,25 μm oder 0,625 μm
- Sichtfeld 1,2x0,9 mm – 6,5x4,9 mm oder 0,6x0,5 mm – 3,3x2,5 mm
- LED-Beleuchtung (oben, unten und koaxial)



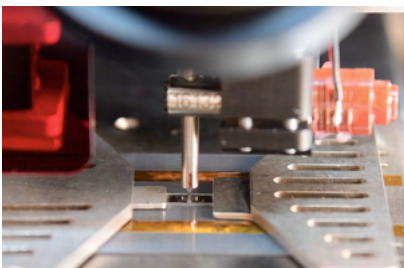
FLIP-CHIP 2X AUTO.

XYZ-motorisierte / programmierbare Version der Standard-Flip-Chip-Option. Sie erhöht die Benutzerfreundlichkeit und ist für die präzise Ausrichtung auf verschiedenen Höhen (z. B. Stapeln) ausgelegt. Darüber hinaus ist sie mit RGBW-LED-Beleuchtung ausgestattet.

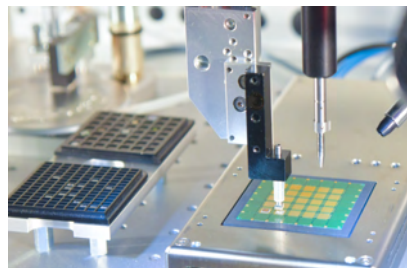


TO Heizung

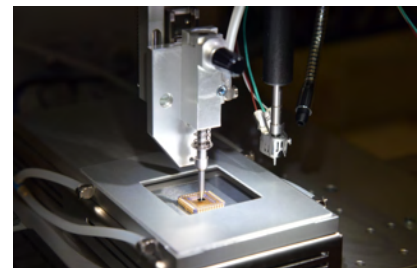
- Heizplatten für statische Temperaturen oder für das Aufheizen/Abkühlen (bis zu 450°C)
- Fluten mit kaltem oder beheiztem Formgas
- Werkzeugheizung für statische Temperaturen oder für das Aufheizen/Abkühlen (bis zu 450°C)
- Software zur Verwaltung verschiedener Temperaturprofile



Scrubbing Bewegung oder Ultraschall-Bonding-Aktion



Stamping für die Anwendung von Klebstoff



2te Spindel für Preform pick-up

T-VERGLEICHE



	T-4909-AE	T-5100	T-5100-W	T-5300	T-5300-W	T-3000-PRO-HF	T-3002-PRO-HF
XY-Bewegung 180mm x 180mm	X						
XY-Bewegung 220mm x 220mm		X	X	X	X	X	X
XY Feinjustierung	X						
XY-Mikrometer Feinjustierung		X	X	X	X	O	O
Z-Bewegung Manuell 100mm	X						
Z-Bewegung Automatisch 100mm						X	X
Z-Bewegung Manuell 125mm		X	X				
Z-Bewegung Automatisch 125mm				X	X		
Z-Bond Kraft überwacht auf dem Bildschirm 20-1000g	X	X	X				
Z-Bond Kraft Kontrolle 20g-10Kg (Middle Force)				X	X		
Z-Bond Kraft Kontrolle 20g-50Kg (High Force)						X	X
Z-Aktive Bond Kraft Kontrolle 20-4000g				X	X		
Z-Lock während Pick & Place Zeit		X	X	X	X	X	X
Z-Stop für Pick		X	X	X	X	X	X
Z-Stop für Place	X	X	X	X	X	X	X
Z-Bond-Linie-Dicke				O	O		
Wafer mit Pneumatischem Die Ausstosser			X				X
Wafer mit Elektronischem Die Ausstosser					X		
Integrierter Dosierer	X	X	X	X	X	X	X
Betrieben von einem Embedded-PC (Linux).	X	X	X				
Betrieben von einem All in One PC (Windows 10)				X	X	X	X
Flip-Chip 1x Man. (MPA 10mmx 30mm)	O					O	O
Flip-Chip 1x Man. (MPA 45mmx 50mm)		O	O	O	O		
Flip-Chip 2x Man. (MPA 45mmx 50mm)		O	O	O	O		
Flip-Chip 2x Auto. (MPA 45mmx 50mm)				O	O		
Flip Station		O	O	O	O	O	O
Tool Heizung mit externem Temperaturregler	O	O	O			O	O
Tool Heizung mit internem Temperaturregler				O	O		
Substrat Statische Heizung mit ext. Temperaturregler	O	O	O			O	O
Substrat Statische Heizung mit int. Temperaturregler				O	O		
Substrat Dynamische Heizung mit ext. Temperaturregler	O	O	O			O	O
Substrat Dynamische Heizung mit int. Temperaturregler				O	O		
Spülen mit Formiergas (kalt und manuell)	O	O	O			O	O
Spülen mit Formiergas (kalt und Software betrieben)				O	O		
Spülen mit Formiergas (warm und Software betrieben)				O	O		
Stanzen	O	O	O	O	O	O	O
Stanzen mit motorisiertem Behälter		O	O	O	O	O	O
Ultraschall (manuell betrieben)						O	O
Ultraschall (Software betrieben)		O	O	O	O		
UV Härtung				O	O	O	O
Hochpräziser Dispenser (Musashi)				O	O	O	O

X Standard enthalten O Option

Note: All specifications are subject to change without notice

Vertreten durch

Hauptsitz

www.tresky.com

Dr. TRESKY AG
 Boenrainstr. 13
 CH-8800 Thalwil
 Schweiz
 Tel.: +41 44 772 1941
tresky@tresky.com

TRESKY Corporation
 704 Ginesi Drive, Suite 11A
 Morganville, NJ 07751
 USA
 Tel.: +1 732 536 8600
sales@tresky.com

